PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-202448

(43) Date of publication of application: 25.11.1983

(51)Int.CI.

G03F

(21)Application number : 57-084784

7/20 **G03F** 9/00

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21.05.1982

(72)Inventor: KAWAMURA YOSHIO

TAKANASHI AKIHIRO

KUNIYOSHI SHINJI KUROSAKI TOSHISHIGE

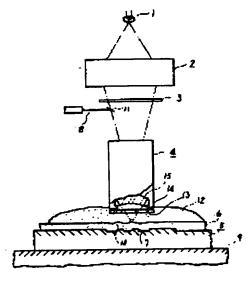
HOSAKA SUMIO

TERASAWA TSUNEO

(54) EXPOSING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the interference fringes of a photoresist layer, to detect the first pattern position with high precision, and to expose the second pattern exactly, by interposing a transparent liquid layer between a lens system and a substrate, and bringing a transparent plate attached to the lens system into contact with the liquid layer. CONSTITUTION: The first pattern 7 is formed on a base 5 and a photosensitive layer 6 is formed on the pattern 7. The pattern 7 is detected with the lens systems 2, 4, and the second pattern to be formed on the photosensitive layer 6 formed on a reticle 3 is registered with the first pattern. The transparent liquid layer 12 is interposed between the lens 4 and the base 5, and the lens 4 is brought into contact with the layer 12 by the medium of a glass plate 4 in the exposing device for exposing the layer 6 to the optical second pattern. As a result, occurrence of interference fringes are reduced, detection accuracy of the first pattern 7 is enhanced, and the second pattern is exactly exposed with this exposing device.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

http://www19.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAA.Laqh3DA358202448P1.htm

3/4/04

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@公開特許公報(A)

昭58-202448

60 Int. Cl.³
G 03 F 7/20
9/00

識別記号

庁内整理番号 7124-2H 7124-2H 砂公開 昭和58年(1983)11月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60露光装置

, ...

②特 顯 昭57-84784

②出 願 昭57(1982)5月21日

仰発 明 者 河村喜雄

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

仍発明者 高梨明紘

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

@発 明 者 国吉伸治

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

切発 明 者 黒崎利栄

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5 番1号

仍代 理 人 弁理士 薄田利幸

最終頁に続く

明細書

発明の名称 露光装置

将許請求の範囲

1. 第1のパターンが設けられ、かつ、その上に 感光剤層が形成された基板における上記第1の パターンをレンズ系を介して模出し、上記感光 削脂を感光すべき第2のパターンと上記第1の パターンとの位値合せを行ない、上記感光剤を 上記第2のパターンでもつて感光させる算光装 世において、上記レンズ系と上記差板との間に 光字的に透明な液体層を介在させ、かつ、上記 レンズ系が光学的に平行で透明な板状部材を介 して上記版体層と接する如く構成してなること を特徴とする第光装置。

発明の詳細な説明

本発明は、半導体業積回路等の製造工程で用い られる第光製館の改良に関するものである。

第1の像細パターンの描かれた半導体基板上の パターンを観察して、相対的な位置合わせを行な つた後、第2のパターンを投影する半導体電光装 置において、観察すべき第1のパターンは凹凸を有する段差状の形状を成しており、その段差状のパターンの上に膨光剤であるホトレジスト層が形成されている。しかし、このホトレジスト層は、観察すべき第1のパターンの凹凸に従っつて凹凸が生じてその室布厚さが均一でなくなり、観察光を限射すると半導体基板からの反射光と半導体基板への入射光とが相互に干渉して、レジスト層の膜厚差による干渉鏡が生じ、観察光学上の障害となっている。

したがつて、本発明の目的は、第1のパターンを有する基板上に形成されたホトレジスト層の襲厚の差によつて生じる干渉額の影響を低板して第1のパターンの位置を高物度に検出し、第2のパターンを正確に貫光する算光装置を提供することにある。

上記目的を選取するために本発明においては、 第1のパターンが設けられ、かつ、その上に思光 列層が形成された基板における第1のパターンを レンズ系を介して検出し、思光利層を感光すべき 第2のパターンと第1のパターンとの位置合せを 行ない、思光剤層を第2のパターンでもつて思光 させる舞光装置において、レンズ系と基板との間 に光学的に透明な液体層を介在させ、かつ、レン ズ系が光学的に平行で透明な板状部材を介して液 体層と接するようにして舞光装置を構成したこと を特徴としている。

• • •

かかる本発明の特徴的な構成により、ホトレジスト層の膜厚のムラに起因する干渉器の影響を抑制することが可能となるため基板上のパターンの位置を正確に検出できる。その結果、高精度な電光が可能な電光装置を提供できるようになつた。

以下、本発明を実施例を参照して詳細に説明す み。

第1図は本発明による電光装置の基本構成を示したものである。電光装置は光源1、コンデンサレンズ2、拡大パターンの揺かれたレテイクル3、縮小投影レンズ4とから構成されてかり、レテイクル3に描かれたパターンを基板である半導体ウエーハ5上に変布された感光剤であるホトレジス

単波長光を用いることれなる。単波長の光を用い て、透明なホトレジスト層6を通して第1のパタ ーン?を検出する際には、ウエーハ5の表面から の反射光とウエーハ 5 への入射光とが互いに干渉 しあつて、ホトレジスト層と空気層とのように思 析器の異なる媒体の接する境界面でホトレジスト 層6の膜厚の差に応じた干渉箱を生じてしまう。 との干渉補は明暗の額状となるため、 第1のパタ ーン7の輪郭と区別することが難しくなり、餌検 出の原因となり、その結果、重ね合せ精度を劣化 させる要因となるものである。特に、第.1のパタ ーン 7 の形状と完全に相似な形状のホトレジスト 層6の膜厚差(凹凸)10が得られる場合には、 干渉縞を用いて、第1のパターン 7の位置を検出 し、これからパターン位置を頻推することも可能 てあるが、現実には、段差を有する第1のパター ン7と相似な形状のホトレジスト層6の膜厚差 (凹凸) 10を得ることは不可能である。

そとで、本発明では上述のホトレジスト層 6 の 藤厚差(凹凸) 1 0 化よる干渉縞の発生を低波し ト層に投影することによつてウェーハ5に所望の パターンを形成するものである。

一般に、半導体素子は、複々の回路パターンを 数回に嵌つて、高精度に位置合わせを行ない重ね 焼きして行く必要がある。重ね焼きを行なうため には、前もつて形成された第1のパターン 7 の位置を検出光学系 8 ,11によつて検出し、ウェー からの無力を移動台 9 を駆動させ、ウェーハ 5 を 原望の位置に位置決めして、レティクル 3 に形する。 通常、上述の第1のパターン 7 は凹凸状の段差形 状を成しているための、レティクル 3 の第2のパターン 8 で でまたするためのホトレジスト層 6 の表示した 大き第一のパターン 7 の凹凸にならった 大き第一のパターン 7 の凹凸にならった。 大き第一のパターン 7 の凹凸にならった。 大き第一のパターン 7 の凹凸にならった。 大き第一のパターン 7 の凹凸になら。

第1のパターン7の位置の検出光学系8,11 は、紹小投影レンズ4を通して第1のパターン7 を検出する。一致に、露光装置に用いられる高解 像刀の縮小投影レンズは、単仮長光用に設計され ているため、検出光学系8,11に使用する光も

て第1のパターン7の検出特度を向上させるため 次の如く構成したものである。干歩縞の発生を低 成させるためにはホトレジスト曲 6 の屈折率とほ **建等しい屈折率を有する液体層12でホトレジス** ト層6の表面をおおりことによりホトレジスト層 6の表面と液体層12との袋する境界面における 屈折率差が小さくなり、ホトレジスト層 6 の表面 ての干渉箱の発生が低波できる。ところが、静止 状態では液体層12の表面は自由表面となるため 平坦となるが、露光装置として用いる場合には、 ウエーハ5を乗せた移動台9が高速にステツブ・ アンド・リピートするため、液体層12の表面は 放打つてしまりという問題が生じる。そとで、被 体層12の縮小投影レンズ4に対する面を常に平 坦に保つために、本発明では、超小投影レンズ4 の下端に光学的に平行で透明なガラス板13を散 けてある。カラス板13は、常に、液体脂12と 接する状態を保つている。縮小投影レンズ4とガ タス板13とはシール材14で仕切られている。 ととて、レンズ15は細小投影レンズ4のレンズ 系を構成するフロントレンズである。ガラス板 13と核体層12との接する境界面でも屈්級率の 型から干渉網の発生もあり得るが、液体層12の 厚さを適当に規定することにより、その境界面を 細小投影レンズ4の焦点保度外の領域に設定する ことは容易であるので、ガラス板13の屈折率は 任意にすることが可能である。

使つて、ガラス板13は紹小投影レンズ4に最適な屈折率を有するものが使用できる。なか、ガラス板13と液体層12とを介した場合の超小投影レンズ4の焦点位置合わせは、移動台9を光軸方向に動かして制御することによつて遅せられる。

上述のように本発明は、主にホトレジスト層 6 の表面に生じる干渉鍋の発生を低減させるという 効果が得られるものであるが、付種的に以下の利 点も得られるものである。

用いる液体層 1 2 を清浄化した、歯髪制御した 状態のものを用いることにより、現在、半導体プロセス上問題となつているウェーハ 5 上への墨埃の付着や、外周囲の画度変化の影響を極わめて小

連体電光装量において、第2のレンズ光学系のウェーハに対面した対物レンズの下端に、本発明を応用することにより、ウェーハ上に塗布されたホトレジストの表面の凹凸に起因する干砂縞による外乱を防いて、検出精度を向上させることができる。

以上説明したごとく、半導体基板に塗布されたホトレジスト層の膜厚のムラによつて生じる干参 編によるウェーハ上のパターンの位置を認検出す ることを防ぐため、ホトレジスト層の屈折率に近 い屈折率の液体層でホトレジスト層の展析率に近 い、かつ、縮小投影レンズの下端に設けた光学的 に平行で透明なガラス板を液体層に接触させた状 悪で駆動する算光装置の構成とすることにより、 高精度なパターンの負ね合わせが行なえるように

また、情浄化された液体層でホトレジスト層の 表面をおおりため、ウエーハ上への防寒対策が容 易になる。さらには、熱容量の大きい液体層を用 いることが可能であるため、外部の温度変化に対 さくするととが容易になり、微細化パターンの形 成を要求される半導体プロセスにおける参習りの 向上が図れる。

上述した実施例において使用したホトレジストはShipley 社のボジティブホトレジスト A21350J であり、このホトレジストを厚さ的1 mmで塗布してホトレジスト層6を形成した。このホトレジスト層6の光の屈折率は約1.65である。また、液体層12は光の屈折率が約1.33の水、光の屈折率が約1.50のベンゼンの2種類を使用した。そして、ガラス板13は低常用いられている尤学ガラスであり、その厚さは23mのものを用いた。この光学ガラスの光の屈折率は約1.5である。

なお、本発明は、干渉編等の外乱を防止できる ため高分解能で、かつ、高精度な微細パターンの 検査装置として応用することも可能である。

また、半導体算光装置における主たる投影光学 系とは別に、第2のレンズ光学系を用いて、ウエ --ハ上のパターンの位置を検出する方式を取る半

するウェーハの変形等も容易に防ぐことが可能と なるなどの付随的な効果も待られる。

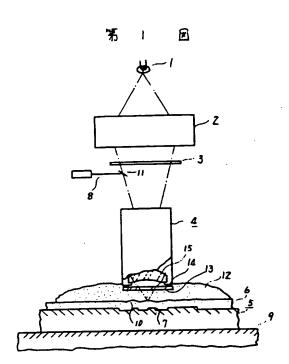
図面の簡単な説明

第1図は本発明による電光装置の概略構成図で ある。

1 …光原、 2 …コンデンサレンズ、 3 …レテイクル、 4 …編小投影レンズ、 5 …基板 (ウエーハ)、 6 …ホトレジスト層、 7 …無 1 のパターン、 8 … 位権検出光学系、 9 …移動台、 1 0 … 膜障差 (凹凸)、 1 1 …ハーフミラー、 1 2 …液体層、 1 3 …ガラス板、 1 4 …シール板、 1 5 …フロントレンズ。

代理人 并理士 再田利幸 克拉拉





第1頁の続き

⑫発 明 者 保坂純男

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑦発 明 者 寺澤恒男

国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内